

SIPLACE TX micron



SIPLACE TX micron		
速度 (ベンチマーク評価)	最大 96,000 cph	
実装精度 (3σ)	最大 20 μm	最大 15 μm
基板サイズ (L×W)	50 mm × 45 mm ~ 375 × 260 mm (デュアルコンベヤ) 50 mm × 45 mm ~ 375 × 460 mm (シングルコンベヤ)	50 mm × 55 mm ~ 250 × 100 mm
マシンサイズ (L×W×H)	1.00 m × 2.23 m × 1.45 m	
部品供給	最大 80 × 8mm のフィーダー、JEDECTレイ	
消費電力 (平均)	2.0 kW : SIPLACE TX2i micron (CP20M3) (1.2 kW : SIPLACE TX2 micron (CPPM))	
エア消費量	120 NI/min (2 x SIPLACE SpeedStar)	
認証	Semi S2/S8、クリーンルームISOクラス7	
データインターフェース	IPC-HERMES-9852、IPC-CFX、IPC-SMEMA-9851	

実装ヘッド	SIPLACE SpeedStar (CP20M3)	SIPLACE MultiStar
速度 (ベンチマーク評価)	最大 48,000 cph	最大 23,850 cph
部品範囲	0.12 × 0.12 mm ~ 8.2 × 8.2 mm*	0.11 × 0.11 mm ~ 27 × 27 mm**
最小リード間隔	70/50* μm	120 μm
最小リード幅	30/25* μm	50 μm
最小ボール間隔	100/50* μm	140 μm
最小ボール径	50/25* μm	70 μm

* オプションの高解像度カメラ (SST49) および青色ライト使用時
** オプションの高解像度カメラ (SST30) 使用時

先端パッケージのテクノロジーパートナー

今日の電子機器生産で主要技術の1つとなっている先端パッケージにより、半導体組立と要件の厳しいSMTアプリケーションの間の境界が狭まっています。

時間、コスト、効率性に対する重要度が高まる中、SiPやSoCの生産、さらには高精度SMTプラットフォームによるダイやフリップチップモジュールの実装がますます一般的になっています。

SIPLACE TX micronは、アドバンスドパッケージングと高密度アプリケーションにおいて最先端のSMTテクノロジーを活用することで、効率性が大幅に低いボンディングソリューションに取って代わります。

ASMは電子機器業界最大のサプライヤーとして、半導体メーカーやOSAT (半導体組立・テスト請負業者) の半導体後工程セグメントおよび、従来型のSMT生産設備に対してサービスを提供しています。

新しいSIPLACE TX micronは、先端パッケージと高密度アプリケーションの両分野から得られた数十年にわたる経験と最新技術を基に開発され、これらの分野の生産性を新たなレベルに押し上げます。



www.asm-smt.com

ENABLING THE DIGITAL WORLD

SIPLACE TX micronの詳細



イー・エス・エム・アッセンブリー・テクノロジー株式会社

〒190-0022 東京都立川市錦町 1-7-18 立川エフビル 5階 | 電話:042 521 7751 | ファックス:042 521 7750 | Eメール:smt-solutions.jp@asmpt.com

Issue 1/01-2021 | All rights reserved. | 注文 No.: A10011-ASM-A135-JA | © ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG

本カタログに記載された情報は一般的な解説および/または性能的な特徴の説明のみを目的としているため、記載された具体的な製品に対して常に当てはまるとは限らず、技術開発や技術進歩によって変更される場合があります。特定の性能および/または機能については、契約上の合意がある場合のみ拘束されるものとします。すべての製品名は、ASM Assembly Systems GmbH & Co. KGあるいはその他サプライヤーの商標または登録商標です。第三者によるそれらの使用は、各所有者の権利侵害に該当する場合があります。

SIPLACE TX micron

先端パッケージ生産における新たなスタンダード

さらなる高速化と高精度 SIPLACE TX micron

先端パッケージと高密度アプリケーション向けの 画期的ソリューション

SIPLACE TX micronにより、SMT最先端技術の性能 (最大 96,000 cph) と比類なき高精度を備えた先端パッケージと、高密度アプリケーションを実現します。1台のマシンで 25、20、15 μm (3 σ) という3種類の精度に対応、実装ピッチはわずか 50 μm 。高性能でアップグレード可能なSIPLACE TX micronは、投資効果を最大限にします。

ダイの亀裂検査やチッピング検出などのスマート機能により、最高レベルの歩留まりと生産性を実現します。

2つの 実装ヘッド

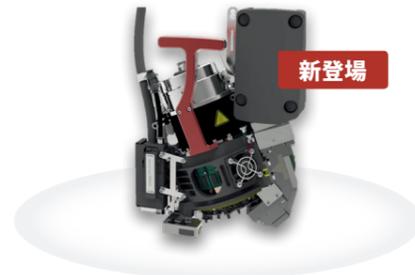
高精度と最高レベルの柔軟性

各部品や実装位置へのタッチレスピックアップやゼロ圧力実装など、実装工程全体を詳細にプログラムできます。



新しい スマートフィーダー

フラックスの検出／検査



SIPLACE SpeedStar

- 部品範囲: 0201(mm) ~ 8.2mm x 8.2mm x 4mm
- 最も繊細な部品に対応: 最小高さ 50 μm の薄型ダイ
- 超高速: 最大 48,000 cph
- 超精密: 最大 $\pm 15 \mu\text{m}$ (3 σ)



SIPLACE MultiStar

- ソフトウェアによる、ピック&プレースからコレクト&プレース、ミックスモードへの自動切り換え
- 部品範囲: 0402 (mm) ~ 27 x 27mm x 6mm
- 高速: 最大 23,850 cph
- 超精密: 最大 $\pm 20 \mu\text{m}$ (3 σ)



SIPLACE Smart Feeder Xi

- 新しい 4mm、8mm、2 x 8mm のフィーダーモジュール
- マイクロテープ対応
- ピックアップ対応: バキュームでブリスターポケット底部の高さを維持し、より高速で正確な部品ピックアップを実現

繊細な部品に対応： 超高精度

繊細な部品に対応

タッチレスピックアップやゼロ圧力実装など、実装工程を個別にプログラム



ダイの亀裂／チッピング検出

最小のDPM (Defect per million) レート (不良率): ビジョンシステムにより、部品の微細な損傷や非常に細かいクラック (亀裂) も減速せずに認識



青色照明ビジョンシステム

微細な部品 (01005、0201m) も識別可能な高コントラスト画像と、特定の特性 (銅パターンの識別)



最大限の性能

2個のガントリーと革新的な実装モードを備えたSIPLACE TX micronは最大 96,000 cph の速度を実現



フラックスの検出／検査

光学制御により、ディッピングユニット使用時の高い歩留まりを確保



クリーンルーム認証

DIN EN ISO 14644-1とSEMI S2/S8によるクリーンルーム ISOクラス7認証



数多くの革新的技術： 設計に基づく高精度

完全な相互作用

数多くの革新的技術を備えたSIPLACE TX micronは、従来の実装精度の限界を打破します。低熱膨張ガラススケールや認識マーク、高解像度の光学センサー、革新的なバキュームツールリングとの完全な相互作用により、最大の性能を発揮しながら極めて高精度な位置決めを実現。その結果、極めて高い精度が求められる超小型部品や非常に狭いピッチの実装の場合でも、最大の品質と生産性が得られます。